

公司代码：600584

公司简称：长电科技

江苏长电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要



第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股本1,779,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配红利355,910,600元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2022年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份行权等事项使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长电科技	600584	G苏长电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏鲲	袁燕
办公地址	江苏省江阴市滨江中路275号	江苏省江阴市滨江中路275号
电话	0510-86856061	0510-86856061
电子信箱	IR@jcetglobal.com	IR@jcetglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为半导体芯片成品制造和测试子行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、高性能计算、消

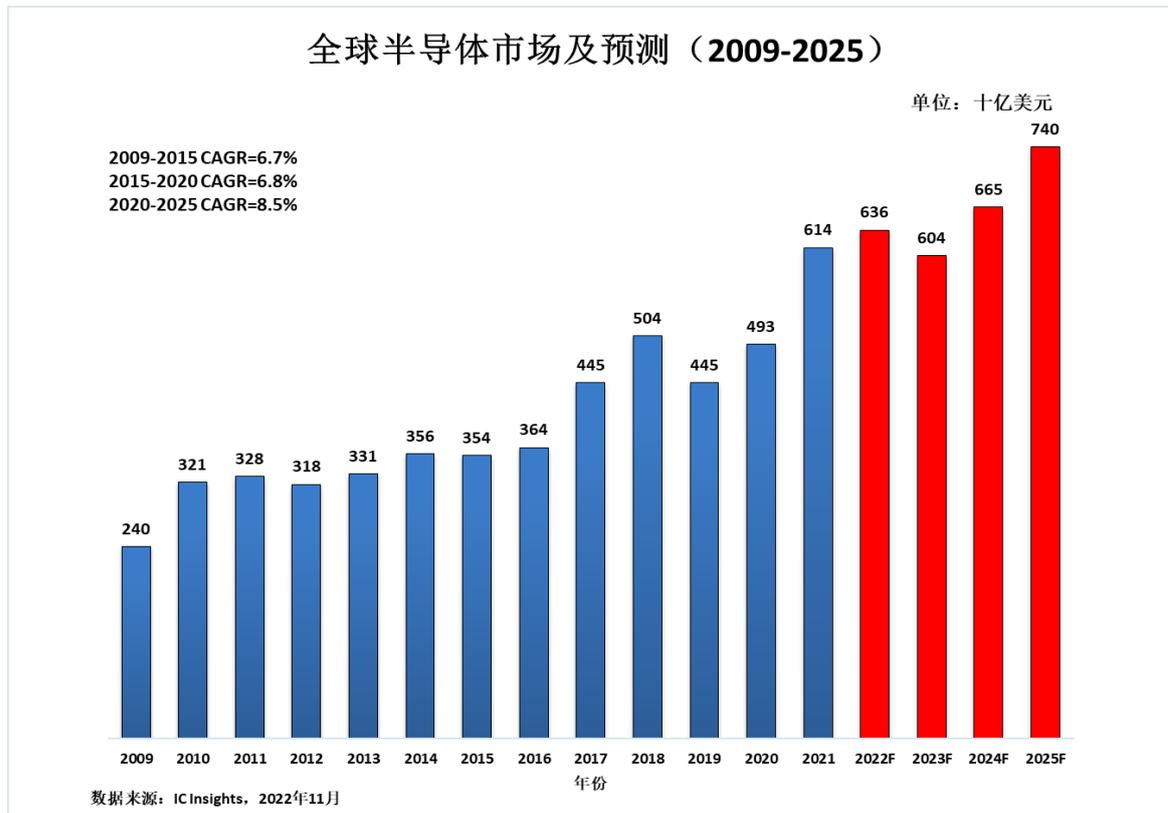
费类、汽车和工业等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路芯片成品制造和测试三个子行业。

1) 半导体市场情况

据半导体产业协会(SIA)公布数据显示,2022 年全球半导体行业销售总额 5,741 亿美元,同比增长 3.3%; 然而 2022 年下半年销售已放缓,其中第四季度销售额为 1,308 亿美元,同比下降 14.3%,环比下降 7.2%。按区域划分,中国仍然是最大的半导体市场,2022 年销售额达 1,804 亿美元,但同比下降 6.2%; 美洲、欧洲、日本同比分别增长 16.2%、12.8%和 10.2%。所有地区 2022 年 12 月的销售额环比均有所下降,中国、美洲、欧洲、日本分别下降 5.7%、6.3%、0.6%、0.5%,12 月全球销售额环比下降 4.3%。虽然半导体市场整体有下滑趋势,但汽车芯片表现亮眼,销售额同比增长 29.2%,达到创纪录的 341 亿美元。

据国际数据公司 (IDC) 最新报告显示,2022 年全球智能手机出货量为 12.1 亿台,同比下降 11.3%; 2022 年第四季度出货量为 3.0 亿台,同比下降 18.3%。据市场调研机构 Canalys 报告显示,2022 年全球个人计算机出货量为 2.85 亿台,同比下降 16%。

从全球半导体产业发展的历史情况来看,半导体产业具有一定的周期性。

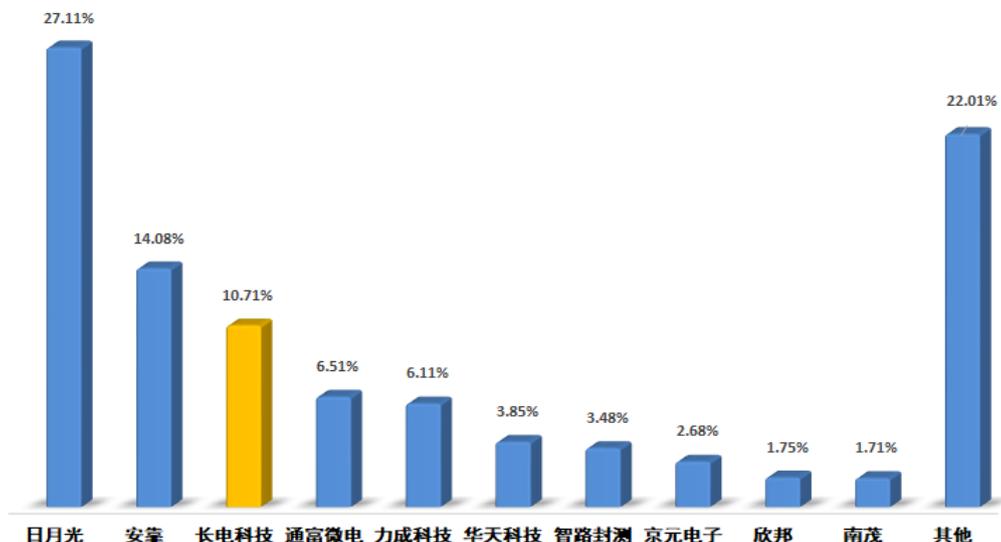


2) 公司的行业地位

根据芯思想研究院 (ChipInsights) 发布的 2022 年全球委外封测 (OSAT) 榜单,长电科技以预估 338 亿元营收在全球前十大 OSAT 厂商中排名第三,中国大陆第一。公司在品牌领导力、多元化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模、运营效率等方面占有明显领先优势。

从近五年市场份额排名来看,行业龙头企业占据了主要的份额,其中前三大 OSAT 厂商依然把控半壁江山,市占率合计近 52%。

2022年全球委外封测市场占有率



数据来源：芯思想研究院2023年2月发布

3) 半导体行业上下游情况:

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路晶圆制造、芯片成品制造和测试、设备和材料行业。公司所属芯片成品制造与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路芯片成品制造与测试的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试等，再由上述客户将产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路芯片成品制造行业的供应商是设备和材料。原材料的供应影响芯片成品制造行业的生产，原材料价格的波动影响芯片成品制造行业的成本。

4) 报告期内公司业务情况

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。公司在中国、韩国及新加坡拥有两大研发中心和六大集成电路成品生产基地，业务机构分布于世界各地，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

通过高集成度的晶圆级 WLP、2.5D/3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的 Flip Chip 和引线互联封装技术，长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。

最近几年公司加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子、5G 通信、高性能计算、存储等高附加值市场的战略布局，持续聚焦高性能封装技术高附加值应用，进一步提升核心竞争力。公司 2022 年度营业收入按市场应用领域划分情况：通讯电子占比 39.3%、消费电子占比 29.3%、运算电子占比 17.4%、工业及医疗电子占比 9.6%、汽车电子占比 4.4%，与去年同期相比消费电子下降 4.5 个百分点，运算电子增长 4.2 个百分点，汽车电子增长 1.8 个百分点。在测试领域，公司引入 5G 射频，车载芯片，高性能计算芯片等更多的测试业务，相关收入同比增长达到 25%。

公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。报告期内，公司

的经营模式未发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	39,407,731,739.01	37,098,618,885.51	6.22	32,328,196,228.34
归属于上市公司 股东的净资产	24,642,733,205.19	20,991,131,608.04	17.40	13,399,706,193.77
营业收入	33,762,028,449.00	30,502,417,851.52	10.69	26,463,994,512.61
归属于上市公司 股东的净利润	3,230,988,205.53	2,958,712,532.84	9.20	1,304,390,209.14
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	2,829,869,778.93	2,486,571,359.81	13.81	951,889,625.26
经营活动产生的 现金流量净额	6,012,468,403.84	7,428,671,369.12	-19.06	5,434,695,224.80
加权平均净资产 收益率(%)	14.19	16.42	减少2.23个百分点	10.02
基本每股收益(元/股)	1.82	1.72	5.81	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.81	1.72	5.23	0.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	8,138,342,221.17	7,455,454,224.93	9,184,232,874.32	8,983,999,128.58
归属于上市公司 股东的净利润	861,427,410.20	682,047,986.79	908,936,683.57	778,576,124.97
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益后的净利 润	781,345,898.68	627,882,860.16	775,655,054.80	644,985,965.29
经营活动产生的现 金流量净额	1,639,597,960.59	1,044,914,611.66	1,695,675,890.43	1,632,279,941.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					336,637		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					340,997		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	236,897,906	13.31	0	无		国有法人
芯电半导体（上海）有限公司	0	228,833,996	12.86	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-5,850,765	42,695,084	2.40	0	未知		未知
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	0	33,579,583	1.89	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,650,947	29,232,051	1.64	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,649,331	17,679,381	0.99	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	5,856,171	14,615,794	0.82	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,770,600	5,790,300	0.33	0	未知		未知
河南战兴产业投资基金（有限合伙）	0	5,300,353	0.30	0	无		境内非国有法人
诺德基金—深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划	0	5,300,353	0.30	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司无实际控制人，前两大股东分别为：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，前两大股东之间不存在任何一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年实现营业收入 337.62 亿元，比上年同口径营业收入增长 10.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 32.31 亿元，同比增长 9.20%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：高永岗

二〇二三年三月二十九日